

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于中芯国际集成电路制造有限公司

2021 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联合保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合保荐机构”）作为中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的联合保荐机构，负责中芯国际上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、2021 年半年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	联合保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	联合保荐机构已与上市公司签署了持续督导协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	联合保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年上半年度，上市公司未出现按有关规定须联合保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相	2021 年上半年度，上市公司及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项。

项目	工作内容
关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	联合保荐机构督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	联合保荐机构督促上市公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	联合保荐机构对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，上市公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	联合保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	联合保荐机构对上市公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021 年上半年度，上市公司及其相关当事人未出现该等事项。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2021 年上半年度，上市公司及其相关当事人不存在未履行承诺的情况。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021年上半年度，上市公司未出现该等事项。
14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上	2021年上半年度，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项目	工作内容
市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	联合保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求。
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	2021 年上半年度，上市公司未出现该等事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021 年上半年度（“报告期”或“本报告期”，下文同），公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

公司面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发风险

公司所处的集成电路晶圆代工行业属于技术密集型行业。集成电路晶圆代工涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来，公司坚持自主研发的道路并进一步巩固自主化核心知识产权。

集成电路晶圆代工的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，可能导致工艺技术定位偏差。同时，新工艺的研发过程较为复杂，耗时较长且成本较高，存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台，可能导致公司竞争力和市场份额有所下降，从而影响公司后续发展。

此外，新技术平台的研发需要大量的资金投入。本报告期和上年同期，公司研发投入分别为19.38亿元和22.79亿元，占收入的比例分别为12.0%及17.3%。如果公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级的需要，可能导致公司技术被赶超或替代，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

2、技术人才短缺或流失风险

集成电路晶圆代工行业亦属于人才密集型行业。集成电路晶圆代工涉及上千道工艺、数十门专业学科知识的融合，需要相关人才具备扎实的专业知识和长期的技术沉淀。同时，各环节的工艺配合和误差控制要求极高，需要相关人才具备很强的综合能力和经验积累。优秀的研发人员及工程技术人员是公司提高竞争力和持续发展的重要基础。

公司多年来一直高度重视人力资源的科学管理，制定了较为合理的人才政策及薪酬管理体系，针对优秀人才实施了包括股权激励在内的多项激励措施，对稳定和吸引技术人才起到了积极作用。近年来在国家政策的大力支持下，集成电路企业数量高速增长，行业优秀技术人才的供给出现了较大缺口，人才争夺日益激烈。如果公司有大量优秀的技术研发人才离职，而公司无法在短期内招聘到经验丰富的技术人才，可能影响到公司工艺研发的进度，对公司的持续竞争力产生不利影响。

3、技术泄密风险

公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和相关技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措

施的局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

4、晶圆代工领域技术升级迭代风险

集成电路丰富的终端应用场景决定了各细分领域芯片产品的主流技术节点与工艺存在差异，且技术迭代与相应市场需求变化较快。若晶圆代工厂商技术迭代大幅落后于产品应用的工艺要求，则无法满足市场和客户的需求。

（二）经营风险

1、公司研发与生产需持续投入巨额资金的风险

集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业。为不断升级现有工艺技术平台以保持市场竞争优势，并保证充足的产能以满足订单生产需求，提高核心竞争力，公司需要持续进行巨额的资金投入。本报告期和上年同期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 94.83 亿元及 98.35 亿元；研发投入分别为 19.38 亿元及 22.79 亿元。未来，如果公司不能获取足够的经营收益，或者融资受限，导致资金投入减少，可能对公司的竞争优势产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

由于集成电路晶圆代工的下游行业市场具有集中度较高的特点，本报告期内和上年同期，公司客户集中度较高，来源于前五大客户的收入占主营业务收入的比例分别为 33.3%及 44.4%。虽然公司凭借自身的研发实力、产品质量、产能支持、服务响应等优势，与主要客户建立了较为稳固的合作关系。但是如果未来主要客户的生产经营发生重大问题，将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影响。

3、供应链的风险

集成电路晶圆代工行业对原材料、零备件和设备等有较高要求，部分重要原材料、零备件及核心设备等在全球范围内的合格供应商数量较少，且大多来自中国境外。未来，如果公司的重要原材料、零备件或者核心设备等发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和/或地区与中国发生贸易摩擦、外交冲

突、战争等进而影响到相应原材料、零备件及设备管制品的出口许可，且公司未能及时形成有效的替代方案，将会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

（三）行业风险

1、产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。国家陆续出台了包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8号）在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面为集成电路企业提供了更多的支持。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

2、晶圆代工市场竞争激烈，公司与行业龙头相比技术差距较大、目前市场占有率较低的风险

随着物联网、人工智能和云计算等新应用领域的不断涌现，芯片产业发展的热点领域在不断丰富，广阔的市场前景及较为有利的产业政策吸引了诸多境内外集成电路相关企业布局集成电路晶圆代工行业，可能将导致市场竞争进一步加剧。

未来，如果公司无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，将削弱公司的竞争优势，并对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）宏观环境风险

1、宏观经济波动和行业周期性的风险

公司主要为客户提供基于多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务，下游应用领域广泛，产品及服务覆盖了包括智能手机、智能家居、消费电子等在内的多个重要经济领域。

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性。因此，集成电路行业的发展与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；此外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，进而影响集成电路晶圆代工企业的盈利能力。宏观经济环境以及下游市场的整体波动可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

自 2020 年初，新型冠状病毒疫情爆发，全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。为应对疫情，公司制定有效的疫情应急防控计划，实施各项防护措施，确保在抗击疫情的同时安全生产。目前为止，疫情暂未对公司的生产经营造成重大不利影响。

但是国际航班的减少及运力的紧张使得设备、零备件及材料供应商的交付周期变长，运输价格的上调将导致公司后续的采购成本增加，人员流动隔离要求也限制了供应商的工程师提供跨国技术配套服务。因此未来若疫情在全球范围内无法得到及时有效的控制或者出现反复，公司仍可能面临供应中断的风险。此外，航班数量、货运时间、运费等因素也可能对公司的出口销售带来一定不利影响。

3、贸易摩擦的风险

本报告期内和上年同期，公司来自中国内地及中国香港以外的国家和地区的主营业务收入占比分别为 40.4%及 36.1%。同时，公司主要供应商多数为境外公司。

目前，中美贸易摩擦持续，经济全球化受到较大挑战，美国在众多领域加强了对中国企业的限制和/或监管，公司的生产经营受到了一定程度的影响。

2020 年 12 月 3 日（美国东部时间），公司被美国国防部列入“中国涉军企业清单”，美国人士对公司发行的有价证券及其相关衍生品的交易受到限制。

2020 年 12 月 18 日（美国东部时间），美国商务部以美国国家安全和外交利益为由，将公司及其部分子公司和联营公司列入“实体清单”。公司被列入“实体清单”后，根据美国《出口管制条例》规定，供应商须获得美国商务部的出口

许可才能向公司供应受《出口管制条例》所管辖的物项。对专用于生产 10nm 及以下技术节点（包括极紫外光技术）的物项，美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核。

2021 年 6 月 3 日（美国东部时间），拜登颁布了一项行政命令，限制美国人士投资“中国军工复合体企业”，美国人士对公司发行的有价证券及其相关衍生品的交易受到限制。

受上述事件影响，公司未来可能无法取得来自美国人士的投资，融资渠道受限，同时获取与生产相关的管辖物项可能存在不确定性。

未来，如果美国或其他国家/地区与中国的贸易摩擦持续升级，限制进出口，提高关税或设置其他贸易壁垒，公司可能面临设备、原材料、零备件等生产资料短缺和客户流失等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

4、美国出口管制政策调整的风险

目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美贸易摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。

2019 年 5 月，美国商务部将部分中国公司列入“实体清单”；2020 年 5 月及 8 月，美国商务部修订“外国直接产品规则”。根据修订后的规则，特定受管辖的半导体设备与技术，在获得美国商务部出口许可之前，可能无法用于生产制造特定客户的产品。

公司坚持国际化运营，自觉遵守生产经营活动所适用国家和地区的法律、法规。自成立以来依法生产、合规运营。但美国不断加强针对中国高科技企业的出口管制政策，可能会导致公司为部分客户提供的晶圆代工及相关配套服务受到一定限制，公司可能面临生产受限、订单减少的局面，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

5、汇率波动的风险

公司及各子公司的记账本位币主要为美元，而部分交易采用人民币或欧元、日元等外币计价。外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位

币，形成汇兑差额。本报告期内和上年同期，公司汇兑收益分别为 0.09 亿元及 0.28 亿元。公司已通过远期外汇合约及交叉货币掉期合约等工具对冲汇率波动的影响。但是未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

（五）财务风险

1、公司未来一定时期内折旧费用进一步增加的风险

截至本报告期末，公司合计在建工程账面价值为 189.99 亿元，占资产总额的比例为 9.1%。公司未来将继续进行产能扩张，并在一定时期内增加在建工程金额。随着在建工程项目陆续达到预定可使用状态而转入固定资产，公司在一定时期内面临折旧费用进一步增加的风险。

2、毛利率降低的风险

本报告期和上年同期，公司毛利率分别为 26.7%和 23.5%。未来，如果集成电路行业整体情况发生不利变化、境内外客户需求未达预期从而影响到公司产品的销量及价格、主要原材料价格大幅上涨、公司加速产能扩充、先进制程产线的扩产使得公司一定时期内折旧费用占收入比重大幅增加，以及其他不利情况发生，公司在未来一定时期内可能面临毛利率波动的风险。

3、业绩波动的风险

本报告期和上年同期，公司营业收入分别为 160.90 亿元和 131.62 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 52.41 亿元和 13.86 亿元，各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 23.39 亿元和 5.42 亿元。

未来，公司若持续产生高额资本开支及研发投入，将导致折旧及研发费用相应增加。一旦公司的投入在短期内不能带来预期收益，或者宏观经济环境、行业周期及行业竞争态势等发生变化，公司可能面临业绩波动的风险。

4、税收优惠政策发生变化的风险

在报告期内，中芯上海、中芯北方和中芯深圳适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率；中芯天津目前处于享受集成电路生产企业“五免五减半”的

企业所得税优惠期内，企业所得税税率为 12.5%；中芯北京目前处于享受集成电路生产企业“十免”的企业所得税优惠期内，企业所得税税率为 0%。

未来，如果上述税收优惠政策发生变化或者上述子公司不再符合相关资质，将对公司未来的所得税费用产生不利影响。

5、资产减值风险

作为资本密集型企业，本集团固定资产规模较大。报告期末，固定资产和在建工程账面价值占总资产的比重为 37.5%。未来，若发生资产市价当期大幅下跌且跌幅明显高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，或公司所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，或市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率等迹象，可能造成资产使用率不足、终止使用或提前处置，或导致资产可收回金额低于账面价值而形成减值，对本集团利润表在当期带来不利影响。

公司报告期内的主要客户均为境内外知名的集成电路设计公司 & IDM 企业，规模较大，信用水平较高，应收账款回款良好。虽然公司主要客户目前发生坏账的可能性较小，但未来如果部分客户的经营情况发生不利变化，公司仍将面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

随着公司销售规模的增长，各期末存货余额亦呈增长趋势。未来，如果市场需求发生变化，使得部分存货的售价未能覆盖成本，公司将面临存货跌价损失增加的风险。

（六）管理内控风险

1、无控股股东和实际控制人的风险

报告期内，公司任何单一股东持股比例均低于 30%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司第一大股东中国信科及相关权益人持股比例为 11.71%，第二大股东鑫芯香港持股比例为 7.81%。董事会现有 15 位董事，各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，

且公司主要股东之间无关联关系或一致行动关系。因此，公司无控股股东和实际控制人。

公司股权相对分散，使得公司未来有可能成为被收购对象，进而导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务发展和经营管理等带来一定影响。

2、公司子公司较多带来的管理控制风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有子公司 27 家，其中境内子公司 18 家，境外子公司 9 家，分布在多个国家和地区。未来，若子公司发生经营、合规、税务等风险，可能对公司的经营业绩造成相关不利影响。

公司的部分控股子公司为中外合资企业，其分红事项需全体董事的三分之二以上批准，公司无法单方面决定分红等重大事项。

（七）法律风险

1、公司的治理结构与适用于中国境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异的风险

公司是一家依据《开曼群岛公司法》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发[2018]21 号），试点红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。公司作为一家在开曼注册的红筹企业，需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，并已按照境内上市规则要求完善了公司治理制度和运行规范，对于投资者权益保护的安排总体上不低于境内法律要求，但在某些公司治理事项安排上如监事会制度，公司合并、分立、收购的程序和制度，公司清算、解散的程序和制度等，与注册在中国境内的一般 A 股上市公司相比还存在一定差异。

2、纠纷诉讼的风险

公司所处的集成电路晶圆代工行业是带动集成电路产业联动的关键环节，且公司经营规模较大，客户、供应商数量众多。在未来的业务发展过程中，公司不能排除因知识产权、合同履行等事项，与客户、供应商等第三方发生纠纷及诉

讼，从而耗费公司的人力、物力以及分散管理精力，并承担败诉后果的风险，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

截至本报告发布日，公司较大的未决诉讼及仲裁包括：1) PDF SOLUTIONS,INC.就其与中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司（“中芯新技术”）签署的一系列技术服务协议提起的仲裁。2) 2020年12月15日公司关于涉及诉讼的公告中显示公司及部分董事被列为被告，指称公司发布的某些陈述或文件违反1934年美国证券交易法第10(b)项和第20(a)项及美国证券交易委员会据此公布的第10b-5规则的规定（该规定禁止与买卖证券相关的某些失实陈述及遗漏），并寻求未确定金额的经济补偿。

四、重大违规事项

2021年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年上半年度，公司主要会计数据如下：

单位：人民币万元

主要会计数据	2021年1~6月	2020年1~6月	增减变动幅度
营业收入	1,609,038.7	1,316,149.9	22.3%
归属于上市公司股东的净利润	524,132.1	138,640.6	278.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,910.4	54,191.5	331.6%
经营活动产生的现金流量净额	1,026,251.9	309,375.5	231.7%
息税折旧及摊销前利润	1,115,819.6	576,311.9	93.6%
主要会计数据	2021年6月末	2020年末	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	10,370,097.3	9,912,803.7	4.6%
总资产	20,772,943.2	20,460,165.4	1.5%

2021年上半年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2021年1~6月	2020年1~6月	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.66	0.26	153.8%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.25	164.0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.10	200.0%

主要财务指标	2021 年 1~6 月	2020 年 1~6 月	增减变动幅度
加权平均净资产收益率（%）	5.2	3.1	增加 2.1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.3	1.2	增加 1.1 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.0	17.3	减少 5.3 个百分点

上述主要会计数据和财务指标的变动原因如下：

1、营业收入增加 22.3%，主要是由于本期内销售晶圆的数量及平均售价上升所致。销售晶圆的数量由上年同期的 2.8 百万片约当 8 英寸晶圆增加 16.2%至本期内的 3.3 百万片约当 8 英寸晶圆。平均售价（销售晶圆收入除以总销售晶圆数量）由上年同期 4,143 元增加至本期的 4,390 元。

2、归属于上市公司股东的净利润增加 278.1%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 331.6%，主要是由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及期内产品组合变动所致。

3、经营活动产生的现金流量净额增加 231.7%，主要是由于销售商品收到的现金增加。

4、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率分别增加 153.8%、164.0%、2.1 个百分点，主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润增加。

综上，2021 年上半年度主要会计数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

（一）研发平台优势

公司研发中心根据总体战略，以客户需求为导向，成熟工艺精进与先进技术开发同时推进。持续在成熟工艺平台基础上拓展特色工艺技术，并且进一步深耕 FinFET 先进技术应用衍生平台。全面确保项目在研发阶段充分对标后续量产技术需求，有效保证产出质量与可靠性，缩短从研发到投产的周期，满足客户产品创新与快速迭代的需求。

（二）研发团队优势

公司通过多年集成电路研发实践,组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队。研发团队的核心成员由境内外资深专家组成,拥有在行业内多年的研发管理经验。

(三) 丰富产品平台和知名品牌优势

公司 20 年来长期专注于集成电路工艺技术的开发,成功开发了 0.35 微米至 14 纳米等多种技术节点,应用于不同工艺技术平台,具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力,可为客户提供智能手机、智能家居、消费电子等不同领域集成电路晶圆代工及配套服务。通过长期与境内外知名客户的合作,形成了明显的品牌效应,获得了良好的行业认知度。

(四) 完善的知识产权体系

公司在集成电路领域内积累了众多核心技术,形成了完善的知识产权体系。截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计获得专利共 12,148 件,其中发明专利 10,382 件。此外公司还拥有集成电路布图设计权 94 件。

(五) 国际化及产业链布局

公司一贯着眼于全球化布局,基于国际化运营的理念,形成较为健全的公司治理结构。组建了国际化的管理团队与人才队伍,建立了辐射全球的服务基地与运营网络,在美国、欧洲、日本和中国台湾设立了市场推广办公室,在中国香港设立了代表处,以便更好拓展市场,快速响应客户需求。公司高度重视与集成电路产业链的上下游企业的战略合作关系,提升产业链整合与布局的能力,构建紧密的集成电路产业生态,为客户提供全方位、一体化的集成电路解决方案。

(六) 完善的质量管理体系

公司不断扩展质量管控的广度和深度,建立了全面完善的质量控制系统。目前公司已经获得了信息安全管理体系认证 ISO27001,质量管理体系认证 ISO9001,环境管理体系认证 ISO14001,职业健康安全管理体系认证 OHSAS18001/ISO45001,汽车行业质量管理体系认证 IATF16949,电信业质量管理体系认证 TL9000,有害物质过程管理体系 QC080000,温室气体排放盘查认

证 ISO14064，能源管理体系认证 ISO50001，道路车辆功能安全认证 ISO26262 等诸多认证。

七、研发支出变化及研发进展

公司 2021 年上半年度研发费用 193,747.4 万元，较上年同期研发费用 227,846.3 万元略有减少。2021 年上半年度，公司研发费用占营业收入比例为 12.0%。

先进工艺方面，多个衍生平台开发按计划进行，稳步导入客户，正在实现产品的多样化目标。

同时，中芯国际特色工艺技术研发进展顺利，多个技术交付量产。55 纳米及 40 纳米高压显示驱动平台进入风险量产，其它项目如特殊存储技术、图像传感技术研发也在稳步进行中。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（万元）
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15
减：支付发行费用	-2,259.43
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	-449,445.27
减：募投项目支出金额	-3,643,473.72
其中：募投项目本期支出金额	983,070.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	31,147.24
截至2021年6月30日募集资金账户余额¹	1,189,788.97

截至2021年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

¹ 美元募集资金专户期末余额采用 2021 年 6 月 30 日人民币对美元汇率中间价 6.4567 进行折算。

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（万元）
招商银行上海分行营业部	NRA110925662010101	活期存款	3.89
招商银行上海分行营业部	NRA110925662032501	活期存款	121,508.64
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	34.22
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	定期存款	100,000.00
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471584	活期存款	562.38
民生银行上海金桥支行	630984295	活期存款	335.50
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	63.95
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196131	活期存款	48,757.38
浦发银行上海虹桥支行	98860078801300001507	活期存款	1,613.76
FT农行上海金桥支行国际部	FTN09778100048500217	活期存款	226,325.67
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN000009907	活期存款	690,583.56

公司 2021 年上半年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 6 月 30 日，中芯国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中芯国际 2021 年上半年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2021 年上半年度，联合首席执行官兼执行董事赵海军售出 163 股港股股份。

除上述事项外，截至 2021 年 6 月 30 日，中芯国际董事和高级管理人员持有的中芯国际股份不存在其他质押、冻结及减持的情形。

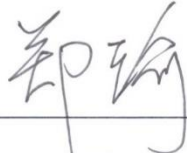
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

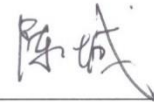
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在联合保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司
2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


郑瑜


陈城



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



魏先勇



李扬

